

平成16年3月期 第3四半期業績の概況 (連結)

平成16年2月6日

上場会社名 株式会社 MARUWA

(コード番号 5344 東証・名証1部)

(URL <http://www.maruwacera.co.jp>)

代表者 代表取締役社長 神戸 誠

問合せ先 取締役 管理部門統括 奥村 研二 (Tel 0561-51-0839)

1. 四半期業績の概況の作成に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

2003年3月期比 新規連結1社増加

(株)MARUWA TFG(旧株東京ファインガラス)は平成15年3月31日に子会社化し、貸借対照表のみ前期に連結しており、損益計算書は当期から連結しております。

公認会計士または監査法人による監査は受けておりません。

2. 連結損益計算書

(単位:百万円)

	第3四半期のみ (10月 - 12月)			9ヶ月累計 (4月 - 12月)		
	当期	前期	前期比(%)	当期	前期	前期比(%)
	平成15年 売上比 (%)	平成14年 売上比 (%)		平成15年 売上比 (%)	平成14年 売上比 (%)	
売上高	3,057	2,445	25.0	8,781	7,875	11.5
売上原価	2,251 74	1,914 78	17.6	6,715 76	6,079 77	10.5
売上総利益	806 26	531 22	51.8	2,066 24	1,796 23	15.0
販売費及び一般管理費	572 19	502 21	13.9	1,705 19	1,495 19	14.0
営業利益	234 8	29 1	706.9	361 4	301 4	19.9
営業外収益(費用)	70 2	17 1	311.8	187 2	10 0	1,770.0
受取利息および配当金	3 0	7 0	57.1	7 0	9 0	22.2
支払利息	2 0	9 0	77.8	10 0	17 0	41.2
為替差益(差損)	18 1	9		24 0	72	
その他	52 2	29 1	79.3	165 2	91 1	81.3
経常利益	304 10	46 2	560.9	548 6	311 4	76.2
特別利益(損失)	20 1	33		41 0	71	
税金等調整前 当期純利益	284 9	13 1	2,084.6	507 6	240 3	111.3
法人税等	35 1	3		143 2	86 1	66.3
当期純利益	249 8	16 1	1,456.3	364 4	154 2	136.4

3. 連結売上高の内訳および前期比較

(単位:百万円)

	第3四半期のみ (10月 - 12月)				9ヶ月累計 (4月 - 12月)			
	当期 平成15年	前期 平成14年	前期比		当期 平成15年	前期 平成14年	前期比	
			金額	(%)			金額	(%)
回路部品	1,396	1,137	259	22.8	3,941	3,488	453	13.0
機構部品	682	288	394	136.8	1,991	1,021	970	95.0
高周波部品	271	262	9	3.4	733	1,017	284	27.9
EMC対策部品	708	758	50	6.6	2,116	2,349	233	9.9
合計	3,057	2,445	612	25.0	8,781	7,875	906	11.5

4. 連結売上高の四半期別推移

(単位:百万円)

	2002年度		2003年度		
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
回路部品	1,137	1,194	1,239	1,306	1,396
機構部品	288	264	637	671	682
高周波部品	262	251	253	209	271
EMC対策部品	758	753	723	685	708
合計	2,445	2,462	2,852	2,871	3,057

(Q=四半期)

事業分野別の概況

当期第3四半期の事業部門別の売上高については、以下のとおりです。

回路部品部門

回路部品部門の売上高は、前年同期比 22.8%増の 13 億 9 千 6 百万円となり、4 四期連続で増収となりました。主力製品である抵抗器用セラミック基板は、前四半期に引き続きDVD機器・デジタルカメラといったデジタル家電や、高性能タイプへの買替え需要が旺盛な携帯電話市場からの受注が好調で、小型抵抗器向けの基板が伸長しました。また、ノートパソコン向けに高付加価値タイプの抵抗器用基板も急増しております。

機構部品部門

機構部品部門の売上高は、前年同期比 136.8%増の 6 億 8 千 2 百万円となりました。当年度4月から販売を開始した石英ガラス製品は、活性化してきた半導体生産装置の市場から堅調な受注がありました。磁気ヘッドサポート材はパソコン用ヘッド部品業界の再編が進む中、第3四半期に入ってから当社への受注が本格化し、シェアを大きく回復してきております。

高周波部品部門

高周波部品部門の売上高は、前年同期比 3.4%増の 2 億 7 千 1 百万円となりました。直前四半期までは継続的に低迷しておりましたが、当四半期から回復基調にあります。デバイス製品は、第2四半期に携帯電話市場で苦戦したものの、第3四半期は一般用途の無線機などへの拡販が増収に寄与しました。誘電体フィルタは、変動の激しい携帯電話部品ユーザーの生産調整期にあり、低調な推移となっています。また、当四半期から光情報機器向けに薄膜基板の受注が増加してまいりました。

EMC対策部品部門

EMC対策部品部門の売上高は、前年同期比 6.6%減の 7 億 8 百万円となりましたが、直前四半期との比較では増加しており、8 月を底に回復傾向にあります。

積層セラミックコンデンサ製品は、国内市場で電源向けや半導体生産装置向け部品が比較的好調でしたが、台湾を中心とした海外市場では、パソコン向け部品を中心に特に価格面での苦戦を強いられました。EMIフィルタ製品は当年度を通じてほぼ横ばいの売上推移となっています。

5. 連結貸借対照表

(Q = 四半期)

(単位:百万円)

	前期	当期		増減	
	15年3月末	15年9月末 (2Q末)	15年12月末 (3Q末)	9ヶ月間	3ヶ月間 (3Qのみ)
(資産の部)					
流動資産	12,697	12,943	13,336	639	393
現金及び預金	5,291	5,782	5,871	580	89
受取手形・売掛金	3,249	3,261	3,714	465	453
たな卸資産	3,847	3,536	3,431	416	105
その他	310	364	320	10	44
固定資産	14,184	13,807	13,430	754	377
有形固定資産	11,912	11,259	10,919	993	340
無形固定資産	440	405	384	56	21
投資その他の資産	1,832	2,143	2,127	295	16
資産合計	26,881	26,750	26,766	115	16
(負債の部)					
流動負債	1,951	1,921	2,056	105	135
支払手形・買掛金	489	482	616	127	134
短期借入金	-	-	-	-	-
その他	1,462	1,439	1,440	22	1
固定負債	1,441	1,309	1,245	196	64
長期借入金	630	556	520	110	36
退職給付引当金	139	143	150	11	7
その他	672	610	575	97	35
負債合計	3,392	3,230	3,301	91	71
少数株主持分	-	-	-	-	-
(資本の部)					
資本金	6,683	6,683	6,683	0	0
資本剰余金	9,710	9,710	9,710	0	0
利益剰余金	7,748	8,232	8,404	656	172
その他有価証券評価差額金	7	28	17	24	11
為替換算調整勘定	443	931	1,147	704	216
自己株式	202	202	202	0	0
資本合計	23,489	23,520	23,465	24	55
負債、少数株主分及び資本合計	26,881	26,750	26,766	115	16
株主資本比率	87.4%	87.9%	87.7%		
1株当たり株主資本(円)	2,136.15	2,139.55	2,134.56		

以上